



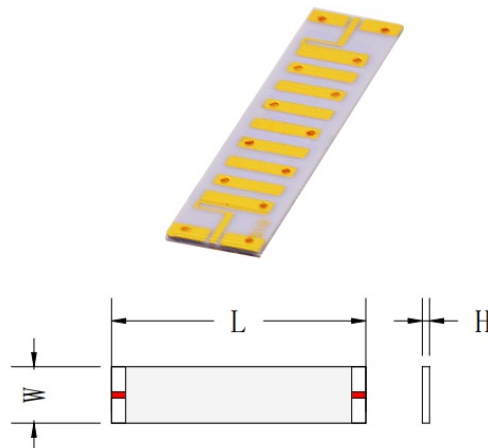
Thin Film Planar Filters

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50 Ω 输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

参数		最小	典型	最大	单位
中心频率			8.9		GHz
工作频率		8.3		9.5	GHz
中心损耗			1.8	2.3	dB
带内波动			0.6	1.0	dB
回波损耗		12	15		dB
带外抑制	@DC-7.5GHz	35	40		dBc
	@10.5-21.0GHz	37	42		dBc

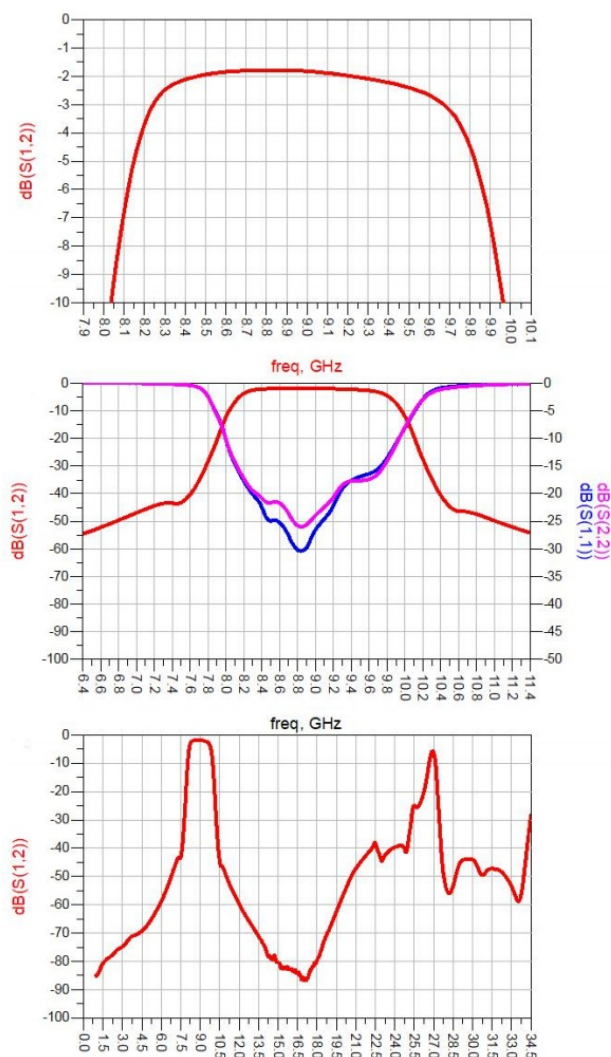
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/℃),载体厚度≥0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

外形图

外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	4.0	0.254	mm

典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



邮箱 sales@com-mw.com

--	--

freq, GHz

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。